公司代码:688209　　公司简称:英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容,请投资者注意投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为29,373,348.62元,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为393,603,811.97元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本报告披露日,公司总股本424,770,660股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数3,873,907股后的股本420,896,753股为基数,以此计算合计派发现金红利11,785,109.08元(含税),占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.12%。2023年度公司不送红股,不进行资本公积转增。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英集芯	688209	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴任超	陈文琪
办公地址	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼
电话	0756-3393868	0756-3393868
电子信箱	zqb@injoinic.com	zqb@injoinic.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司,涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。公司利用数模混合的优势技术,在单芯片集成各种丰富功能,响应客户需求提供高集成、高性价比且能灵活配置的电源管理SoC芯片,快速发展成为国内主要的电源管理芯片供应商之一。公司未来将持续耕耘锂电池相关的应用市场,拓展布局低功耗物联网、新能源、汽车电子、智能音频处理、智能家居等新方向。

(二)主要经营模式

报告期内,公司经营模式无重大变化。公司采用Fabless 的经营模式,主要从事芯片的设计与销售,将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。在此模式下,有助于公司深耕研发创新,聚焦行业发展新动态,推出性能优良、竞争力强的产品。

1、研发模式

公司始终将芯片的设计研发作为公司运营活动的核心。公司紧密跟随市场的变化趋势,将市场动态与客户需求通过一系列研发工作转化成性能优良、竞争力强的产品,并不断进行产品更新迭代,拓展产品的应用领域,以满足不断发展的市场需求。

公司的产品研发按照公司规定的流程严格管控,具体研发流程包括项目立项、方案开发、项目开发、项目验证(样片测试)、项目量产、项目结项等阶段。

2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售,通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试,公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动,灵活高效等特点。

在Fabless模式中,公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控,产品的生产则采用委外加工的模式完成,即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前,公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务,公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

3、销售模式

公司目前采用“经销为主,直销为辅”的销售模式,即公司既通过经销商销售产品,又向终端厂商直接销售产品。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、所处行业

公司主营业务是电源管理芯片和快充协议芯片的研发和销售。公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。

2、行业发展情况

集成电路是国家的支柱性产业,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,不仅对国民经济和生产生活至关重要,而且对国家的信息安全与综合国力具有战略性意义。

由于我国集成电路产业起步较晚,在技术和人才等方面与美国、日韩企业存在一定差距,目前我国在集成电路产业的主要核心技术尚存在较大的赶超和创新空间。为掌握集成电路产业核心技术,实现芯片自主自立,近年来我国相继出台了多项法律法规和政策支持集成电路产业的发展。我国制定和印发的“十四五”规划、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《中国制造 2025》均明确提出要大力发展和扶持集成电路产业,这为国内集成电路企业提供了良好的外部环境。

近年来,在人工智能、5G、大数据中心、汽车等应用快速发展的推动下,我国集成电路的产业规模不断扩大,国产芯片的科研实力不断增强,正逐渐缩小与国外同行业的技术差距,芯片国产替代效应越发强劲,国内集成电路行业仍有较大的市场空间。根据中商产业研究院分析师预测,2023年中国集成电路设计行业销售额将达到6543亿元,2024年将增至7852.2亿元。

由于2023年第二季度和第三季度半导体市场的强劲表现,WSTS 将2023年整体增长预测略微上调。WSTS调高了2023年及2024年对于全球半导体市场的预估,预计2023年全球半导体营收将达到5201.26亿美元,高于先前预估值5150.95亿美元。同时预计2024年全球半导体市场将复苏,营收将达到5883.64亿美元,年增13.1%

模拟芯片是市场规模巨大的集成电路产品之一,也是电子系统中不可或缺的部分,其应用范围极其广泛,拥有广大的市场空间。根据WSTS数据,2022年全球半导体市场的总规模为5740.84 亿美元,其中集成电路市场规模占据整个半导体市场规模的82.6%,模拟芯片市场规模占据整个半导体市场规模的15.5%。

根据模拟芯片的功能和应用领域分类,主要可以分为电源管理芯片、信号链芯片。电源管理芯片是在电子设备系统中负责所需电能的变换、分配、检测等管控处理的芯片,是所有电子产品和设备的电能供应中枢和纽带。电源管理芯片性能的优劣将对整机的性能产生直接影响,属于电子设备不可或缺的一部分。由于各类电子产品和设备都具有电压调节等电源管理需求,所以电源管理芯片下游应用场景广泛,目前已广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、移动通信等领域,与人们的生活息息相关。根据 Frost&Sullivan 数据,预计2025年全球电源管理芯片市场规模将达526亿美元,2020年至2025年年均复合增速 9.8%。

公司专注于高性能、高品质的数模混合芯片设计。自成立以来,经过公司不断的研发和创新,在数模混合SoC集成技术、快充接口协议全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度ADC和电量计技术、大功率升降压技术等方面拥有深厚的技术积累。公司推出的电源管理芯片具有高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。产品受到了市场和行业的广泛认可。公司的快充协议芯片具有较强的市场竞争力,是获得全球首个QC5.0认证,首批Vooc SuperVooc授权厂商,取得PD认证芯片品类较多的厂商。因此,公司成为了消费电子市场主要的电源管理芯片和快充协议芯片供应商之一。报告期内产生销售收入的产品型号约335款,对应的产品子型号数量超过4441个,芯片销售数量超过12亿颗。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO、vivo及Sumsung等知名厂商。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、电源管理芯片领域

电源管理芯片拥有广阔的终端应用领域,近年来,随着芯片技术的创新与提升,应用范围还在持续扩张,不仅覆盖消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等传统产业领域,更在人工智能、物联网、云计算、无线充电、新能源汽车、可穿戴设备等新兴市场获得新的机遇。终端应用的拓展推动着电源管理芯片向前发展,将促使厂商对电源管理芯片产生更大的需求,进一步拓宽电源管理芯片市场,为产业带来发展的新机遇。

(1)储能电源市场

在全球能源短缺以及双碳目标的背景下,传统能源向清洁能源转型成为全球共识,目前全球已有130多个国家和地区相继提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,实现绿色可持续发展已经成为全世界的广泛共识。随着我国“双碳”目标的快速推进,储能领域也将进入高速增长阶段。

(2)汽车电源管理市场

汽车行业正在不断向“电动化”和“智能化”发展,在上述趋势推动下,车载电源管理芯片的需求会逐渐增加,单辆汽车中的芯片价值量将会提升,汽车电源管理领域也会逐渐拓宽,汽车市场前景广阔。根据睿略行业研究,2022年全球汽车电子市场规模为830.86亿元, 预测全球汽车电子市场规模在2028年将会达到964.43亿元,CAGR增长2.37%。

(3)AI电源管理市场

随着人工智能和AIGC的快速发展,以AI服务器为核心的算力基础设施需求不断扩大。同时,GPU、CPU等算力芯片朝着更高性能升级也对供电系统提出更高要求。因此AI服务器的增长带动了电源管理芯片的需求,AI服务器电源管理市场空间广阔。根据Trendforce,2023年全球AI服务器出货量预计120万台,在整体服务器中的渗透率约为9%,2026年渗透率提升至约15%,2022-2026年CAGR=22%。

随着AI技术的应用拓展不断扩大,在PC、手机、智能音箱、智能眼镜等终端设备上不断应用发展,用于AI的存储器产品需求强劲, 从而推动了存储电源管理芯片的需求增长。根据Yole,2021年全球内存接口芯片及配套芯片(RCD+DB+PMIC+SPD+TS)市场规模为7.1亿美元,2028年该规模预计为40.0亿美元,2021-2028年总市场规模CAGR为28%。未来随着AI PC、AI手机等需求增长,都将带动存储电源管理芯片的市场需求。

(4)无线充电市场

近年来,随着技术迭代和消费者需求的变化,电子产品的充电需求逐渐附加技术、场景等多样性特征,无线充电技术应运而生。无线充电技术不需要匹配消费电子的充电插口型号,使用方便,极大满足了消费者的需求,市场规模得以稳步扩张。目前,无线充电技术主要应用在智能手机、笔记本电脑,可穿戴设备和厨房电器等电子设备,未来无线充电的应用进一步拓展至家具、家电、电动汽车等领域。

(5)TWS耳机市场

近年来,随着TWS耳机在运动、学习、驾驶、搭乘交通工具等多元化场景应用的推广,TWS耳机需求量快速增长。根据Canalys发布的数据显示,2023年第四季度,全球真无线耳机(TWS)市场呈现稳健的增长态势,出货量同比增长6.5%,较去年增加了500万台。未来,随着TWS音质续航等性能提升、运动状态监测和心率检测等功能丰富,以及技术的不断升级,都将带动TWS耳机市场需求。

(6)可穿戴设备市场

随着AI、VR、AR等先进技术在可穿戴设配的普及,目前市场上主要的可穿戴设备的形态呈现多元化,如智能眼镜、智能手表、运动手环、可穿戴医疗智能设备、VR头戴智能等设备,未来随着互联技术的发展,将带动低功耗电源管理技术在可穿戴设备上的应用。

2、快充协议芯片领域

随着消费者使用智能设备的时间越来越长,智能设备续航问题日渐突出。5G手机普遍比传统智能手机耗电更多。为了追求便携轻薄,智能手机的电池容量较难进一步提升,于是针对智能手机的快充技术应运而生。为了同时兼容普通充电器和不断迭代的大功率快充充电器,同时保证快充的安全性,在手机和快充充电器之间需要新增快充协议芯片,来沟通协调快充的电压/电流,应对各种异常状态的安全保护。英集芯研发了快充接口协议全集成技术,并在快充协议芯片的稳定性、安全性方面进行了深入研发。

(1)快充电源适配器市场

近年来,随着智能移动设备功能的逐渐丰富,设备耗电量也随之上升。在设备配置的锂电池容量有限的情况下,智能设备快速充电功能的重要性逐渐增加,快充电源适配器市场逐渐得到消费者的关注,并在需求的不断带动下得以高速发展。随着快充电源适配器的推广,快充协议芯片作为快充电源适配器的重要部件,需求有望进一步提升。随着5G手机等智能终端设备的推广、快充电源适配器渗透率的提升,快充电源适配器市场发展迅速;此外,苹果等公司逐渐取消前装适配,第三方快充电源适配器市场也得到了进一步发展。

(2)智能手机设备市场

支持快充协议的智能手机设备也需要用到手机端快充协议芯片。快充手机在智能手机市场的渗透率不断上升,已经从高端机型渗透至中低端机型。同时,充电速度更快的快充协议也不断应用于新款智能手机,最新PD3.1快充协议的最大功率已从100W扩大至240W。未来随着AI大模型在手机上的使用,对于智能手机的快速充电功能要求日益重要。

(3)平板电脑、笔记本电脑

根据IDC,2023年全球笔记本电脑出货量达1.8亿台,预计2024、2025年全球笔记本电脑出货量达1.9、2亿台。根据IDC,预计2023年平板电脑出货量1.4亿台,未来2024、2025年出货量增长0.5%。同时随着AI PC的普及,将拉动更多消费者换机的需求。根据Canalys统计和预测数据,2024年兼容AI的个人电脑出货量占比有望从2023年的10%提升到19%,2027年预计提升至60%。支持快充功能的平板电脑、笔记本电脑的电源适配器端和设备端都需要使用快充协议芯片,是快充协议芯片的重要应用市场,未来快充协议芯片在该领域的需求有望持续增长。

(4)电动工具

电动工具是快充协议芯片的重要应用市场之一。近年来,随着电钻、电动螺丝刀、冲击扳手等电动工具小型化、便携化的趋势,无绳类充电电动工具逐渐获得推广。支持快充功能的无绳电动工具的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片。根据EVTank数据,2022年全球电力工具出货量达4.7亿台,全球市场规模达521.6亿美元,预计到2026年全球电动工具出货量将超过7亿台,复合增速约10%,市场规模或将超过800亿美元。

(5)智能家居设备市场

内置锂电池的智能音箱、智能灯、智能小家电等智能家居设备也是快充协议芯片的重要应用领域。支持快充功能的智能家居设备的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片,随着智能家居市场不断优化升级,智能家居设备市场迎来新的发展机会。根据IDC,2022年出货量约2.6亿台,预计到2026年预计突破5亿台。

3、信号链领域

信号链芯片得益于应用场景广泛,下游需求带来信号链芯片发展新契机。近年来,在下游电子产品整机产高速增长的带动下,中国信号链芯片市场保持稳定的增长。根据IDC,全球信号链模拟芯片的市场规模将从2016年84亿美元增长至2023年118亿美元,年均复合增速约5%,下游应用领域广阔且相关应用终端发展繁荣,未来强劲的下游需求将是带动整个模拟芯片产业持续增长的强劲动力。

(1)高速接口芯片市场

高速传输接口芯片是当代电子系统中承担系统互联、数据传输的核心元器件,随传输技术的发展持续迭代升级。在全球平板、手机、笔电、可穿戴设备、车载显示等市场不断发展下,终端设备数量和传输数据量高倍增长,推动了传输接口数量和种类的增加和变化,以及信号传输技术的发展换代。随着人工智能、万物物联、智能汽车等领域快速增长, 全球流量引来爆发式增长。根据IDC 预计全球数据流量将从2018 年的33ZB 增加至2025 年的175ZB,CAGR 达26.9%,有助于高速传输介面芯片市场快速成长。

(2)智能音频芯片市场

音频功放芯片,是各类音响器材中不可缺少的部分,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。随着应用设备的小型化,音频功放芯片逐步向智能化、节能化、高效率等方向突破演进,并通过与算法相结合,提升音频响度、清晰度和立体效果,同时对芯片和设备提供保护。随着手机、音响、车载、可穿戴设备、计算机设备、智能家居等下游应用领域的需求扩张。根据机构报告数据显示,2021年全球音频放大器市场销售额达到了1670.31百万美元,预计2028年将达到2470.05百万美元,年复合增长率(CAGR)为5.63%(2022-2028)。未来,音频功放芯片行业终端应用景气度蓬勃。

(3)BMS市场

受益于快充技术的迅速发展,电动车、智能家居、便携式储能的产品持续放量,BMS作为关键的核心部件,需要更高的性能和可靠性,未来BMS芯片会有更加广阔的市场空间。据前瞻产业研究院整理,2021年全球BMS市场规模为65.12亿美元,预计2026年可达到131亿美元,CAGR为15%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,983,660,889.53	1,872,024,594.19	5.96	807,068,568.23
归属于上市公司股东的净资产	1,830,418,154.26	1,755,071,644.65	4.29	679,433,037.64
营业收入	1,215,775,044.39	867,261,374.92	40.19	780,718,304.81
归属于上市公司股东的净利润	29,373,348.62	154,913,066.58	-81.04	158,273,806.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,640,087.97	143,389,729.58	-89.09	206,928,605.68
经营活动产生的现金流量净额	38,090,179.23	-42,039,684.56	不适用	193,567,541.27
加权平均净资产收益率(%)	1.66	11.31	减少9.65个百分点	26.71
基本每股收益(元/股)	0.07	0.38	-81.58	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.38	-81.58	0.42
研发投入占营业收入的比例(%)	25.18	19.26	增加5.92个百分点	12.52

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	220,583,847.53	295,066,062.20	327,269,137.60	372,856,997.06
归属于上市公司股东的净利润	-14,994,444.07	17,075,793.22	13,656,937.44	13,635,062.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,854,519.14	9,516,627.36	12,117,460.28	9,860,519.47
经营活动产生的现金流量净额	-38,966,529.82	146,408,837.34	-29,795,515.49	-39,556,612.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,061
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
珠海英集投资合伙企业(有限合伙)	0	104,535,837	24.61	104,535,837	104,535,837	无	0	其他
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	-190,000	104,188,785	24.53	0	0	无	0	其他
北京芯动能投资基金(有限合伙)	-900,000	35,338,895	8.32	0	0	无	0	其他
共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,902,300	19,147,736	4.51	0	0	无	0	其他
珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)	0	14,341,564	3.38	14,341,564	14,341,564	无	0	其他
共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,988,600	9,915,343	2.33	0	0	无	0	其他
成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)	0	6,925,208	1.63	6,925,208	6,925,208	无	0	其他
黄烘伟	160,000	4,719,433	1.11	4,569,433	4,719,433	无	0	境内自然人
珠海展祥资本管理有限公司-佛山市展祥凯鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,068,511	4,702,597	1.11	0	0	无	0	其他
上海科技创业投资有限公司	-2,600,000	4,469,470	1.05	0	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海英集投资合伙企业(有限合伙)、珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)、成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其执行事务合伙人均为公司实际控制人黄烘伟;共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城展想股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其基金管理人均为上海兴橙投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

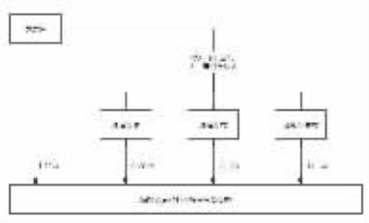
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,215,775,044.39元,较上年同期增长40.19%;实现归属于上市公司股东的净利润29,373,348.62元,较上年同期减少81.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,640,087.97元,较上年同期减少89.09%。

报告期末,公司总资产1,983,660,889.53元,较上年度末增长5.96%;归属于上市公司股东的净资产1,830,418,154.26元,较上年度末增长4.29%。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688209　　证券简称:英集芯　　公告编号:2024-021

深圳英集芯科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“英集芯”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年4月15日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事,因增加董事会临时提案,公司于2024年4月22日将补充通知送达各位董事,经全体董事同意,本次会议按期召开。本次会议由公司董事长黄烘伟先生召集和主持;会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于(公司2023年度总经理工作报告)的议案》

经审议,董事会同意《关于(公司2023年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于(公司2023年度董事会工作报告)的议案》

经审议,报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,报告期内公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于(公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意《关于(公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五)审议通过《关于(公司对会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意《关于(公司对会计师事务所履职情况评估报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。

(六)审议通过《关于(公司独立董事2023年度述职报告)的议案》

经审议,报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(公司独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

经审议,董事会同意《关于(公司独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)《关于(公司2023年年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,公司2023年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2023年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,决策程序合法有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年年度报告》及《英集芯2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于(公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意《关于(公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2024-023)。

(十一)审议通过《关于(公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会同意向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税)。公司以截至本公告披露日的总股本424,770,660股扣除公司回购专用证券账户中股份数3,873,907股后的股本420,896,753股为基数,计算合计拟派发现金红利人民币11,785,109.08元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为40.12%。2023年度公司不送红股,不进行资本公积转增。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-024)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,直接提请董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-025)。

(十四)审议通过《关于公司2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,公司2024年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合相关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。

(六)审议通过《关于(公司独立董事2023年度述职报告)的议案》

经审议,报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(公司独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

经审议,董事会同意《关于(公司独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意《关于(公司2023年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)《关于(公司2023年年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,公司2023年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2023年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,决策程序合法有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年年度报告》及《英集芯2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于(公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,董事会同意《关于(公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)审议通过《关于(公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

经审议,《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2023年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会同意向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税)。公司以截至本公告披露日的总股本424,770,660股扣除公司回购专用证券账户中股份数3,873,907股后的股本420,896,753股为基数,计算合计拟派发现金红利人民币11,785,109.08元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为40.12%。2023年度公司不送红股,不进行资本公积转增。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票